



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20130306001
2013 年 3 月 20 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

SVA SOIC パッケージ 一部製品 Cu(銅)ボンディングワイア変更のご案内

関連通知

(旧 NS 社 Forecast PCN20123202 2012 年 3 月 17 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての最終版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただきます。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input checked="" type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling <input type="checkbox"/> -		
変更内容	SVA SOIC パッケージ 一部製品 Cu(銅)ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 変更後 : Cu(銅)線			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	5月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルは4月上旬の出荷より予定しています。)			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容：弊社 SVA(シリコンバレーアナログ) SOICパッケージ 一部製品について、現行 Au(金)線ボンディングワイアを使用して製造していますが、機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、これに替えて、Cu(銅)線ボンディングワイアに変更します。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイア	Au(金)線	Cu(銅)線

	現行	変更後
ボンディングワイア (部材, 径)	Au, 0.9mil & 1.0mil	Au, 0.9mil & 1.0mil or Cu, 0.96 mil
モールド樹脂	8096859	8096859
チップ接着剤	8080598	8080598
リードフレーム表面処理	Matte Sn or SnPB	Matte Sn or SnPB

理由：機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

詳細：

本通知の対象製品は、すべて旧 National Semiconductor 社 PCN システムより発行された既報 Forecast PCN20123202 (2012年3月17日発行)に含まれています。

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名				
ADC08831IM	DS90LV027AHMX	LM4865MX/NOPB	LM77C1M-5	LMV344MAX/NOPB
ADC08831IM/NOPB	DS90LV027AHMX/NOPB	LM4871M	LM77C1M-5/NOPB	LMV344MAX/S5000800
ADC08831IMX	DS90LV027ATM	LM4871M/NOPB	LM77C1MX-3	LMV344MAX/S7002582
ADC08831IMX/NOPB	DS90LV027ATM/NOPB	LM4871MX	LM77C1MX-3/NOPB	LMV358M
ADC08832IM	DS90LV027ATMX	LM4871MX/NOPB	LM77C1MX-5	LMV358M/NOPB
ADC08832IM/NOPB	DS90LV027ATMX/NAK2	LM4875M	LM77C1MX-5/NOPB	LMV358MX
ADC08832IMX	DS90LV027ATMX/NOPB	LM4875M/NOPB	LM86C1M	LMV358MX/DRSN
ADC08832IMX/NOPB	DS90LV027M	LM4875MX	LM86C1M/NOPB	LMV358MX/E7002867
ADCV08832CIMX	DS90LV027M/NOPB	LM4875MX/NOPB	LM86C1MX	LMV358MX/MESN
ADCV08832CIMX/NOPB	DS90LV027MX	LM4876M	LM86C1MX/NAK2	LMV358MX/NOPB
CLC001AJE	DS90LV027MX/NOPB	LM4876M/NOPB	LM86C1MX/NOPB	LMV393M
CLC001AJE/NOPB	DS91C176TMA	LM4876MX	LM89-1CIM	LMV393M/NOPB
CLC001AJE-TR13	DS91C176TMA/NOPB	LM4876MX/NOPB	LM89-1CIMX	LMV393MX
CLC001AJE-TR13/NOPB	DS91C176TMAX	LM4880M	LM89CIMX	LMV393MX/NOPB
DS10CP152TMA/NOPB	DS91C176TMAX/NOPB	LM4880M/NOPB	LM89CIMX/NAK2	LMV393MX/S5000873
DS10CP152TMAX/NOPB	DS91C180TMA	LM4880MX	LM89CIMX/NOPB	LMV722M
DS36C200M	DS91C180TMA/NOPB	LM4880MX/NOPB	LM92CIM	LMV722M/NOPB
DS36C200M/NOPB	DS91C180TMAX	LM4881M	LM92CIM/NOPB	LMV722MX
DS36C200MX	DS91C180TMAX/NOPB	LM4881M/NOPB	LM92CIMX	LMV722MX/NOPB
DS36C200MX/NOPB	DS91D176TMA/NOPB	LM4881MX	LM92CIMX/NOPB	LMV761MA
DS90C031BTM	DS91D176TMAX	LM4881MX/NOPB	LM95245CIM	LMV761MA/NOPB
DS90C031BTM/NAK2	DS91D176TMAX/NOPB	LM4889MA	LM95245CIM/NOPB	LMV761MAX
DS90C031BTM/NOPB	DS91D180TMA	LM4889MA/NOPB	LM95245CIMX	LMV761MAX/NOPB
DS90C031BTMX	DS91D180TMA/NOPB	LM4889MAX	LM95245CIMX/NOPB	LMV762MA
DS90C031BTMX/NOPB	DS91D180TMAX	LM4889MAX/NOPB	LME49721MA/NOPB	LMV762MA/NOPB
DS90C031TM	DS91D180TMAX/NOPB	LM4890M	LME49721MAX/NOPB	LMV762MAX
DS90C031TM/NOPB	DS91M0477TMA/NOPB	LM4890M/NOPB	LMH0002MA	LMV762MAX/NOPB
DS90C031TMX	DS91M0477TMAX/NOPB	LM4890MX	LMH0002MA/NOPB	LMV772MA
DS90C031TMX/NOPB	DS91M124TMA/NOPB	LM4890MX/NOPB	LMH0002MAX	LMV772MA/NOPB
DS90C032BTM	DS91M124TMAX/NOPB	LM4991MA	LMH0002MAX/NOPB	LMV772MAX
DS90C032BTM/NOPB	DS91M125TMA/NOPB	LM4991MA/NOPB	LMH0002TMA	LMV772MAX/E5002752
DS90C032BTMX	DS91M125TMAX/NOPB	LM4991MAX	LMH0002TMA/NOPB	LMV772MAX/E7002744
DS90C032BTMX/NOPB	DS92001TMA	LM4991MAX/NOPB	LMH0002TMAX	LMV772MAX/NOPB
DS90C032TM	DS92001TMA/NOPB	LM63C1MA	LMH0002TMAX/NOPB	LMV822M
DS90C032TM/NAK2	DS92001TMA/S5001568	LM63C1MA/NOPB	LMP2011MA	LMV822M/NOPB
DS90C032TM/NOPB	DS92001TMAX	LM63C1MAX	LMP2011MA/NOPB	LMV822MX
DS90C032TMX	DS92001TMAX/NOPB	LM63C1MAX/NOPB	LMP2011MAX	LMV822MX/NOPB
DS90C032TMX/NOPB	DS92LV010ATM	LM63D1MA	LMP2011MAX/NOPB	LMV822MX/S5002129
DS90C401M	DS92LV010ATM/NOPB	LM63D1MA/NOPB	LMP2012MA	LMV824M
DS90C401M/NOPB	DS92LV010ATMX	LM63D1MAX	LMP2012MA/NOPB	LMV824M/NOPB
DS90C401MX	DS92LV010ATMX/NOPB	LM63D1MAX/NAK2	LMP2012MAX	LMV824MX
DS90C401MX/NOPB	LM4808M	LM63D1MAX/NOPB	LMP2012MAX/NOPB	LMV824MX/NOPB
DS90C402M	LM4808M/NOPB	LM74C1M-3	LMP8358MA/NOPB	LMV824MX/S5000461
DS90C402M/NOPB	LM4808MX	LM74C1M-3/NOPB	LMP8358MAX/NOPB	LMV824MX/S7002283
DS90C402MX	LM4808MX/NOPB	LM74C1M-5	LMV2011MA	LMV824MX/S7002463
DS90C402MX/NOPB	LM4818MX	LM74C1M-5/NOPB	LMV2011MA/NOPB	LMV932MA
DS90CP22M-8	LM4818MX/NOPB	LM74C1MX-3	LMV2011MAX	LMV932MA/NOPB
DS90CP22M-8/NOPB	LM4819MX	LM74C1MX-3/NOPB	LMV2011MAX/NOPB	LMV932MAX
DS90CP22MX-8	LM4819MX/NOPB	LM74C1MX-5	LMV324M	LMV932MAX/J7002026
DS90CP22MX-8/NOPB	LM4860M	LM74C1MX-5/E7000843	LMV324M/NAK2	LMV932MAX/NOPB
DS90LV001TM	LM4860M/NOPB	LM74C1MX-5/NOPB	LMV324M/NOPB	LMV934MA
DS90LV001TM/J7001651	LM4860MX	LM74C1MX-5/S7001825	LMV324MX	LMV934MA/NOPB
DS90LV001TM/NOPB	LM4860MX/NOPB	LM75A1M/NOPB	LMV324MX/E7001889	LMV934MAX
DS90LV001TMX	LM4861M	LM75A1MX/NOPB	LMV324MX/E7002869	LMV934MAX/J7002007
DS90LV001TMX/J7001652	LM4861M/NOPB	LM75B1M-3	LMV324MX/NOPB	LMV934MAX/NOPB
DS90LV001TMX/NAK2	LM4861MX	LM75B1M-3/NOPB	LMV339M	LP2995M
DS90LV001TMX/NOPB	LM4861MX/NOPB	LM75B1M-5	LMV339M/NOPB	LP2995M/J7001142
DS90LV017ATM	LM4862M	LM75B1M-5/NOPB	LMV339MX	LP2995M/NOPB
DS90LV017ATM/NOPB	LM4862M/NOPB	LM75B1MX-3	LMV339MX/NOPB	LP2995MX
DS90LV017ATMX	LM4862MX	LM75B1MX-3/NAK2	LMV342MA	LP2995MX/J5000192
DS90LV017ATMX/E7001864	LM4862MX/NOPB	LM75B1MX-3/NOPB	LMV342MA/NOPB	LP2995MX/J7001045

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

DS90LV017ATMX/NAK2	LM4864M	LM75B1MX-5	LMV342MAX	LP2995MX/NOPB
DS90LV017ATMX/NOPB	LM4864M/NOPB	LM75B1MX-5/NOPB	LMV342MAX/E7002870	LPV324MX
DS90LV019TM	LM4864MX	LM76CHM-5	LMV342MAX/J7002023	LPV324MX/NOPB
DS90LV019TM/NOPB	LM4864MX/NAK2	LM76CHM-5/NOPB	LMV342MAX/NOPB	LPV358M
DS90LV019TMX	LM4864MX/NOPB	LM76CHM-5	LMV342MAX/S7002483	LPV358M/NOPB
DS90LV019TMX/NOPB	LM4865M	LM76CHM-5/NOPB	LMV344MA	LPV358MX
DS90LV027AHM	LM4865M/NOPB	LM77C1M-3	LMV344MA/NOPB	LPV358MX/NOPB
DS90LV027AHM/NOPB	LM4865MX	LM77C1M-3/NOPB	LMV344MAX	

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2012年12月30日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	DS90CP22MX-8	-	-	
Assembly Site:	TIEM	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	8075531	Mold Compound:	8096859	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**T/C	JESD22-A104, -65C/150C, 500 Cyc	80/0	80/0	80/0
**ACLV	JESD22-A102, 121C, 96 Hrs	80/0	80/0	79/0
Notes: **Tests received preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2013年2月6日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	LP2995MX/NOPB	-	-	
Assembly Site:	TIEM	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	8080598	Mold Compound:	8095179	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**Autoclave	121C, 96 hrs	79/0	80/0	80/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	80/0	80/0	80/0
Destructive Physical Analysis	Post Temp Cycle	Approved	Approved	Approved
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
CSAM/TSAM	Post Temp Cycle	Approved	Approved	Approved
Notes: **Tests received preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2012年9月9日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	LM93C1MT/NOPB	-	-	
Assembly Site:	TIEM	Package/Code/Pins:	TSSOP/DGG/56	
Mount Compound:	8080598	Mold Compound:	8095181	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	-	-
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 hrs	80/0	80/0	80/0
Notes: **Tests received preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				